

FINANCIAL REPORT

FY2022

4Q

Result



HIRANO TECSEED

連結決算説明資料

2023年3月期

第4四半期

東証スタンダード : コード 6245

The Standard Market of the TSE.Code No.6245

URL <https://www.hirano-tec.co.jp/>

会社概要

社名

株式会社ヒラノテクシード

代表者

取締役社長: 岡田 薫

資本金

¥1,847,821,888 (2023年3月末時点)

所在地

奈良県北葛城郡河合町大字川合101番地の1

グループ会社
(出資比率100%)

- ヒラノ技研工業株式会社
- 株式会社ヒラノK&E

従業員数

300名(連結:394名)(2023年3月末時点)

銘柄コード

6245(機械)

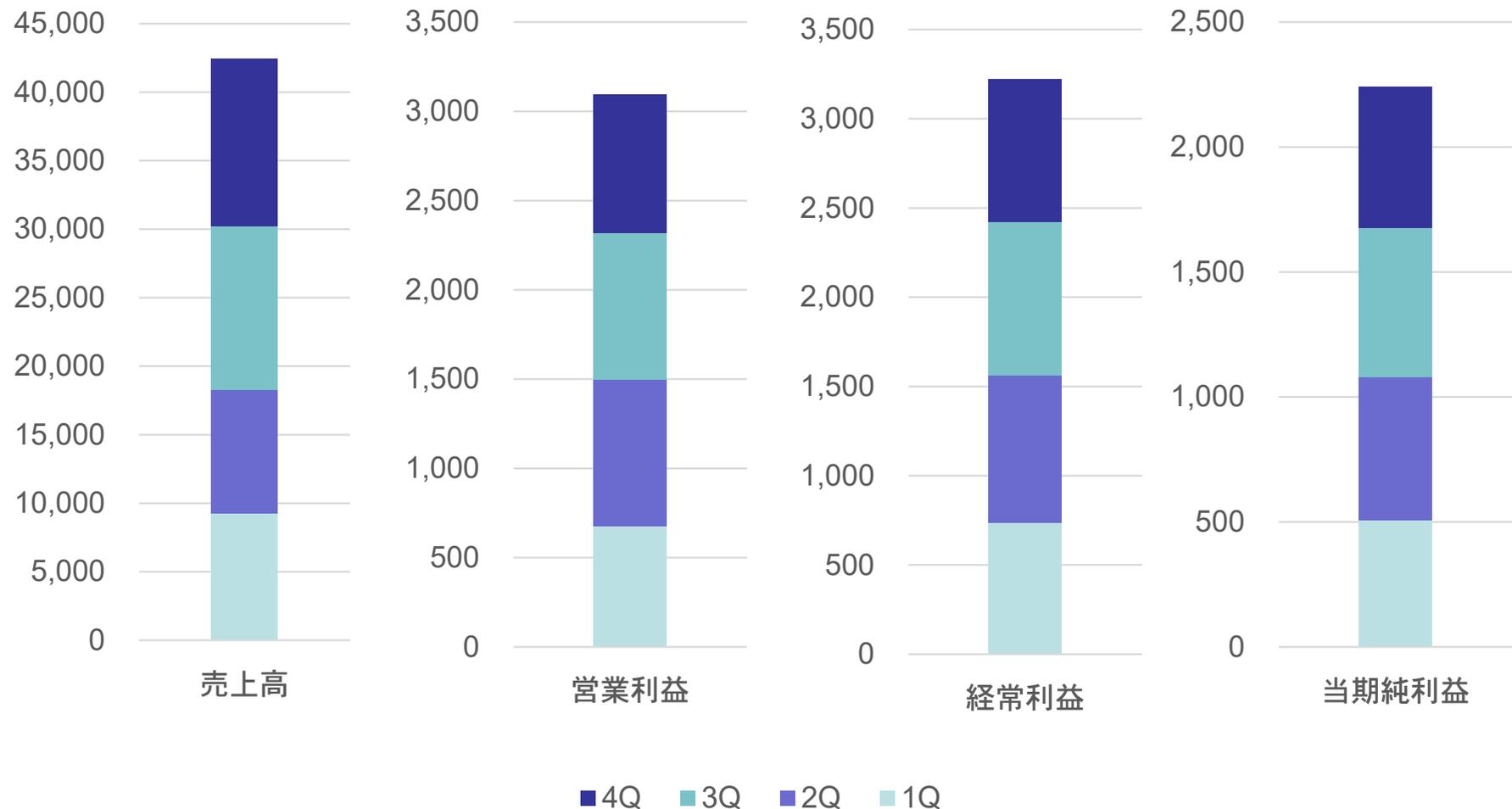
当連結会計年度の概要

(単位:百万円)

	累計期間		
	4Q 2021.4.1~ 2022.3.31	4Q 2022.4.1~ 2023.3.31	前年同期比
売上高	37,866	42,423	+12.0%
営業利益	3,986	3,093	△22.4%
経常利益	4,122	3,219	△21.9%
当期純利益	3,103	2,243	△27.7%

当連結会計年度の概要

(単位:百万円)



通期予想進捗率

101.0%

91.0%

92.0%

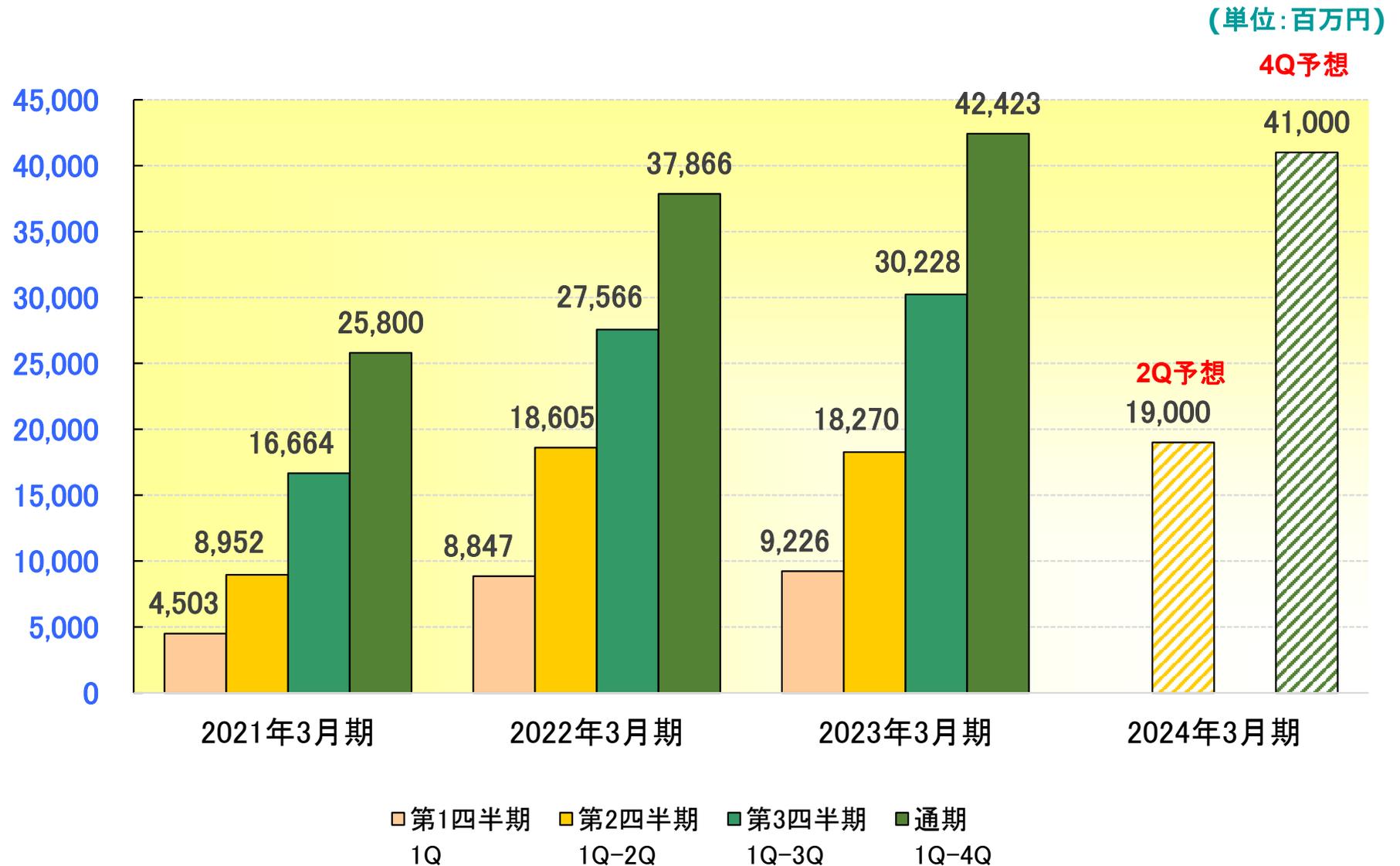
86.3%

資産指標

(単位:百万円)

	2022.3.31	2023.3.31	前期末比
流動資産	38,953	48,158	+23.6%
固定資産	11,508	12,363	+7.4%
流動負債	15,104	23,428	+55.1%
固定負債	894	1,096	+22.7%
純資産	34,463	35,997	+4.4%
総資産	50,461	60,522	+19.9%
自己資本比率 (%)	68.3%	59.48%	—

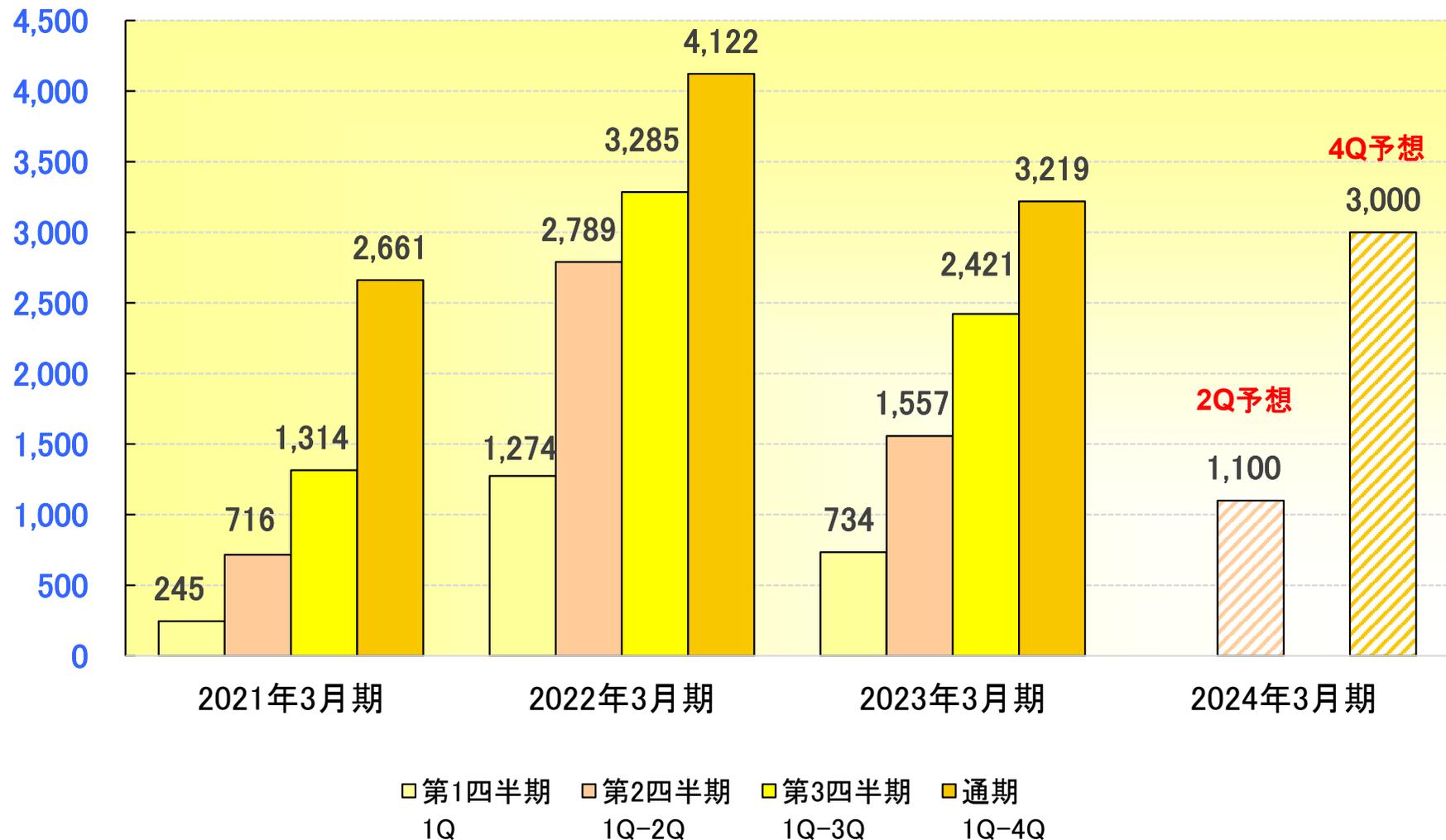
売上高の推移（累計期間）



「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期の数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

経常利益の推移（累計期間）

(単位:百万円)

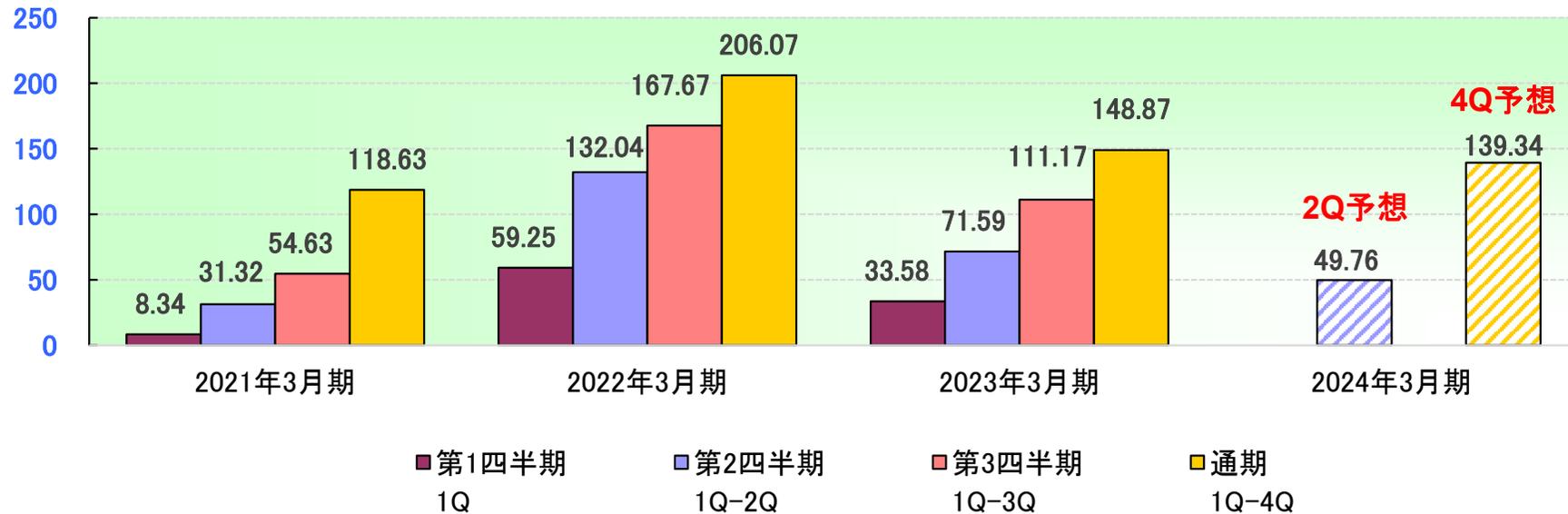


「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期の数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

1株当たりの純利益及び1株当たり配当金

1株当たり純利益

(単位:円)



「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期の数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

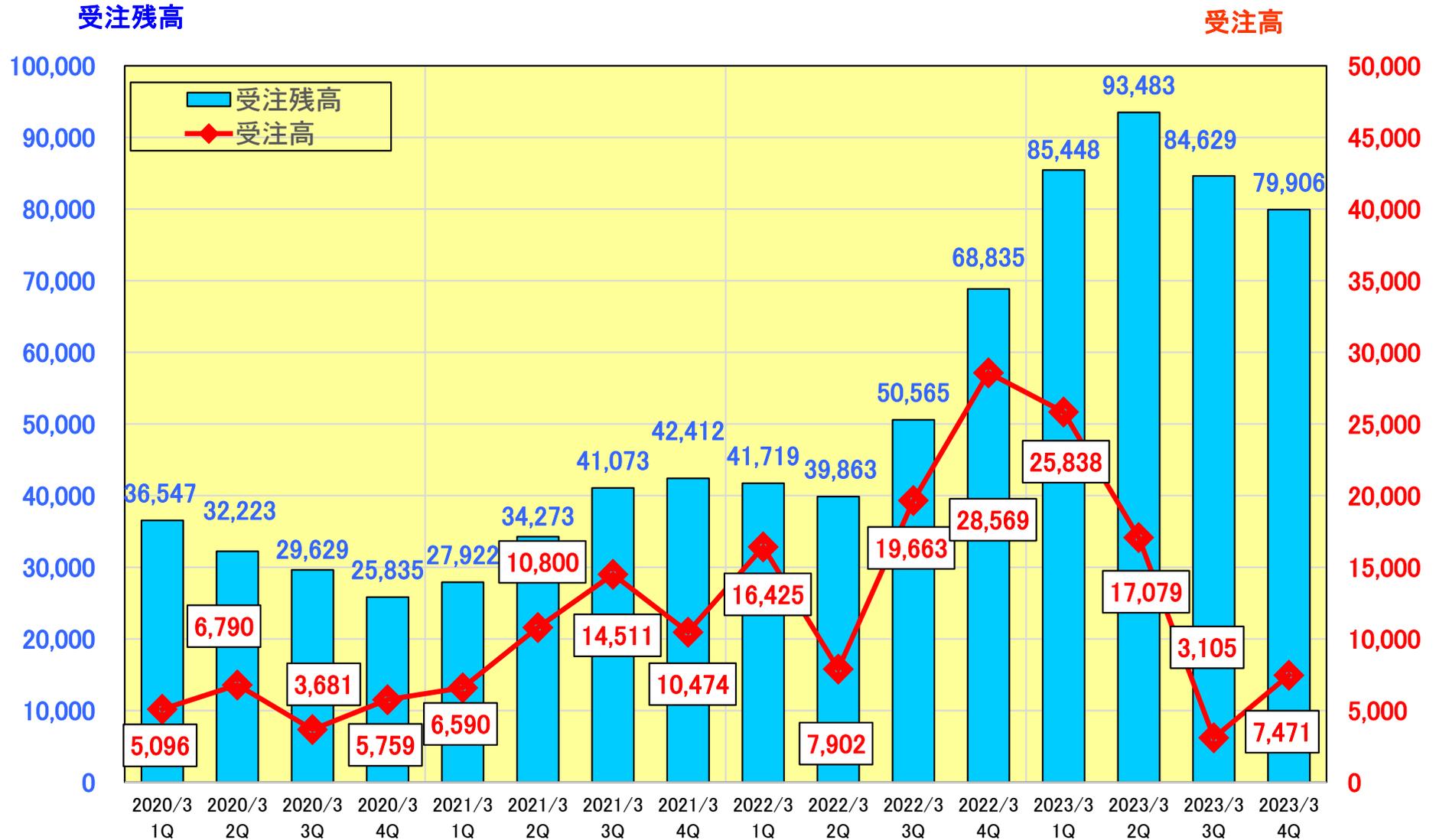
1株当たり配当金

◆当社は株主各位への配当金は、企業の収益状況により決定するものと考えており、安定的な配当の維持を基本としております。

		中間	期末	通期計
2022年3月期		28	28	56
2023年3月期		28	28	56
2024年3月期	予想額	28	28	56

受注高・受注残高の推移（四半期会計期間別）

(単位:百万円)



※2020年3月期1Q 成膜装置△1,460百万円減額修正

セグメント情報

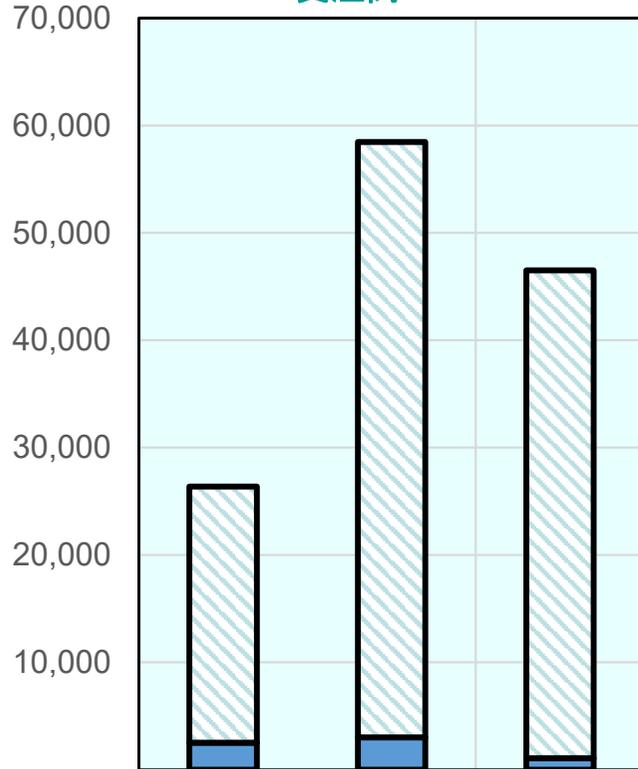
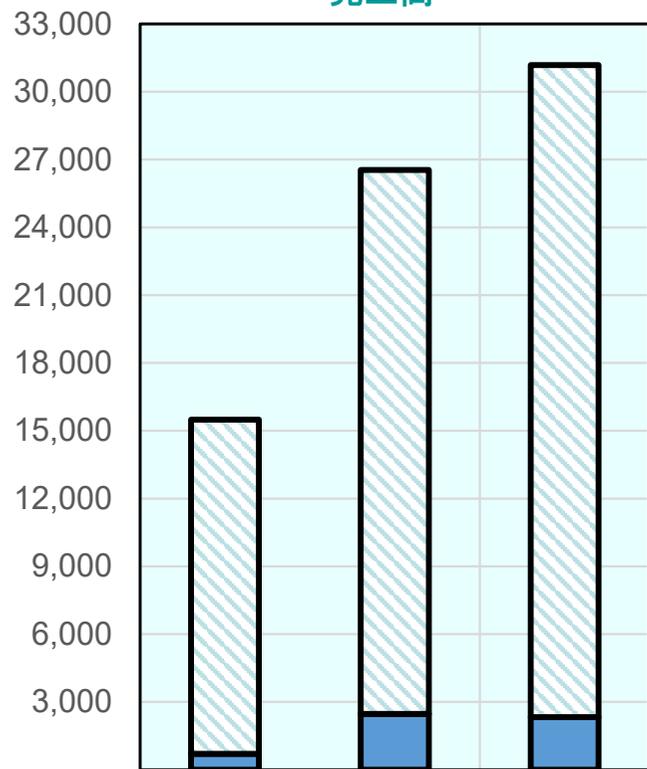
	用途別セグメント	機械の種類別セグメント（開示ベース）
ディスプレイ関連	光学機能フィルム	塗工機関連機器
	真空機器	化工機関連機器
電子材料関連	成膜装置	化工機関連機器
	電気・電子	塗工機関連機器
生活用品関連	粘着テープ	塗工機関連機器
	新素材・複合材	化工機関連機器
	染色整理機械	その他
エネルギー関連	Lib電池他	塗工機関連機器

※用途別セグメントは主な市場又は機器を掲載しております。

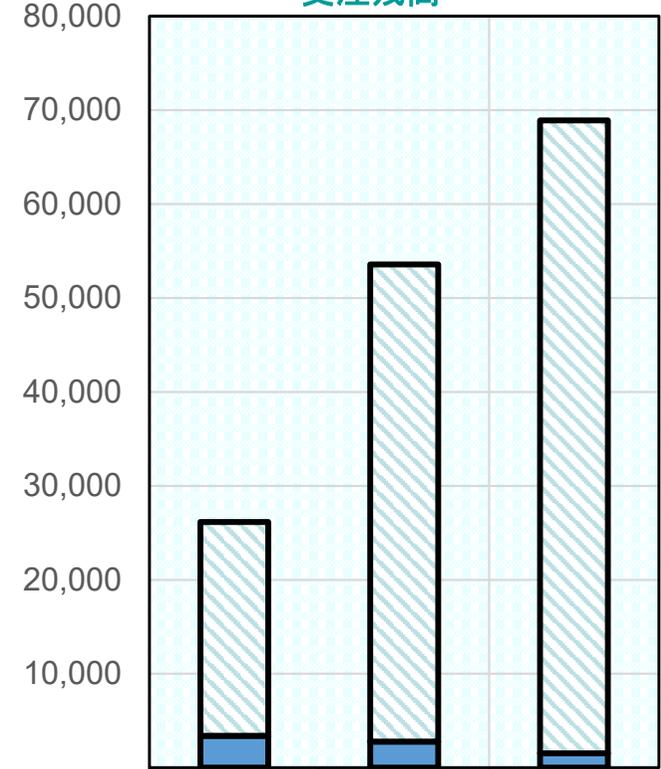
塗工機関連機器部門

(単位:百万円)

売上高



受注残高



	2021年 3月期 1Q-4Q	2022年 3月期 1Q-4Q	2023年 3月期 1Q-4Q
海外	14,777	24,067	28,851
国内	708	2,465	2,327
合計	15,485	26,533	31,179

	2021年 3月期 1Q-4Q	2022年 3月期 1Q-4Q	2023年 3月期 1Q-4Q
海外	23,859	55,457	45,429
国内	2,518	3,009	1,074
合計	26,378	58,466	46,503

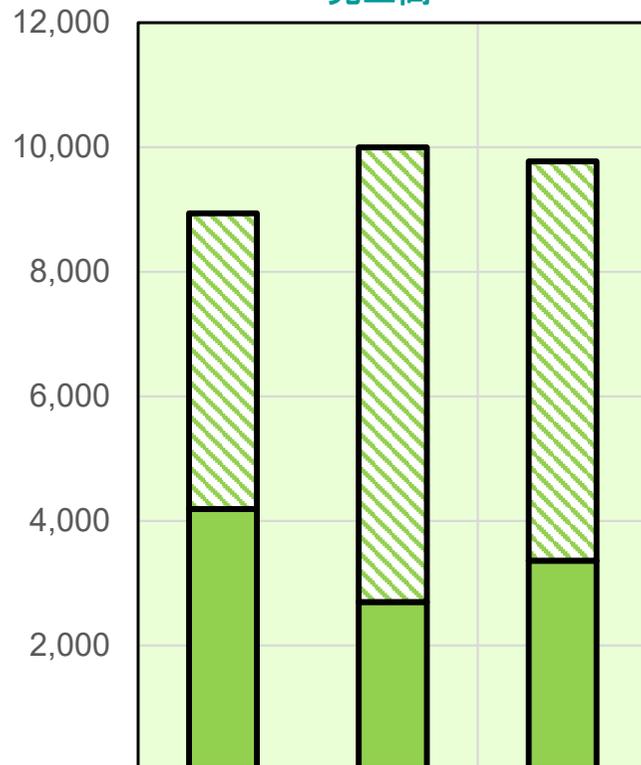
	2021年 3月期 4Q末	2022年 3月期 4Q末	2023年 3月期 4Q末
海外	22,763	50,800	67,378
国内	3,409	2,787	1,533
合計	26,172	53,588	68,912

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しております。

化工機関連機器部門

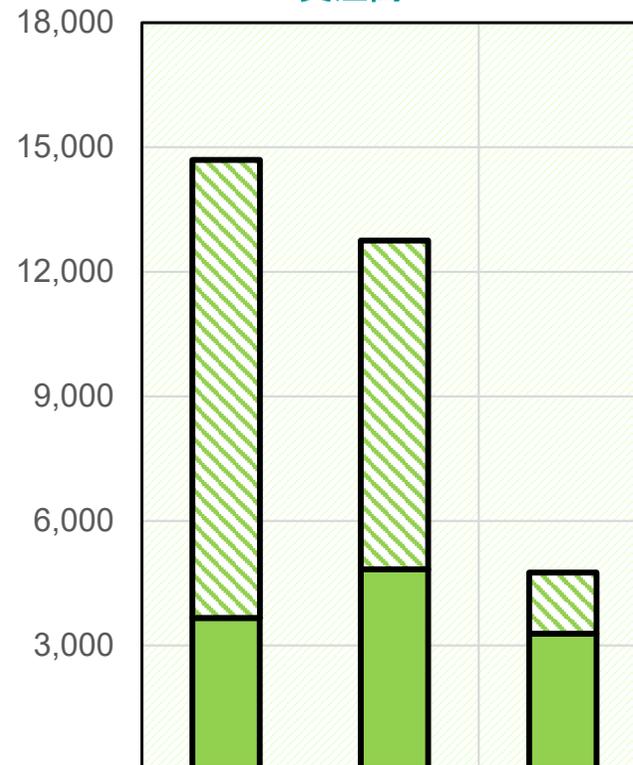
(単位:百万円)

売上高



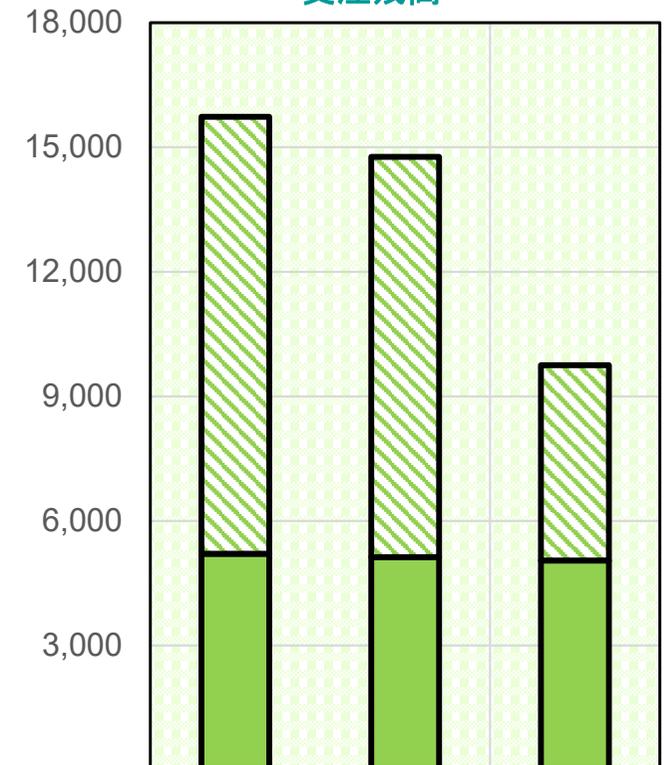
	2021年 3月期 1Q-4Q	2022年 3月期 1Q-4Q	2023年 3月期 1Q-4Q
海外	4,746	7,300	6,410
国内	4,192	2,698	3,363
合計	8,938	9,998	9,774

受注高



	2021年 3月期 1Q-4Q	2022年 3月期 1Q-4Q	2023年 3月期 1Q-4Q
海外	11,029	7,922	1,474
国内	3,665	4,835	3,282
合計	14,694	12,757	4,757

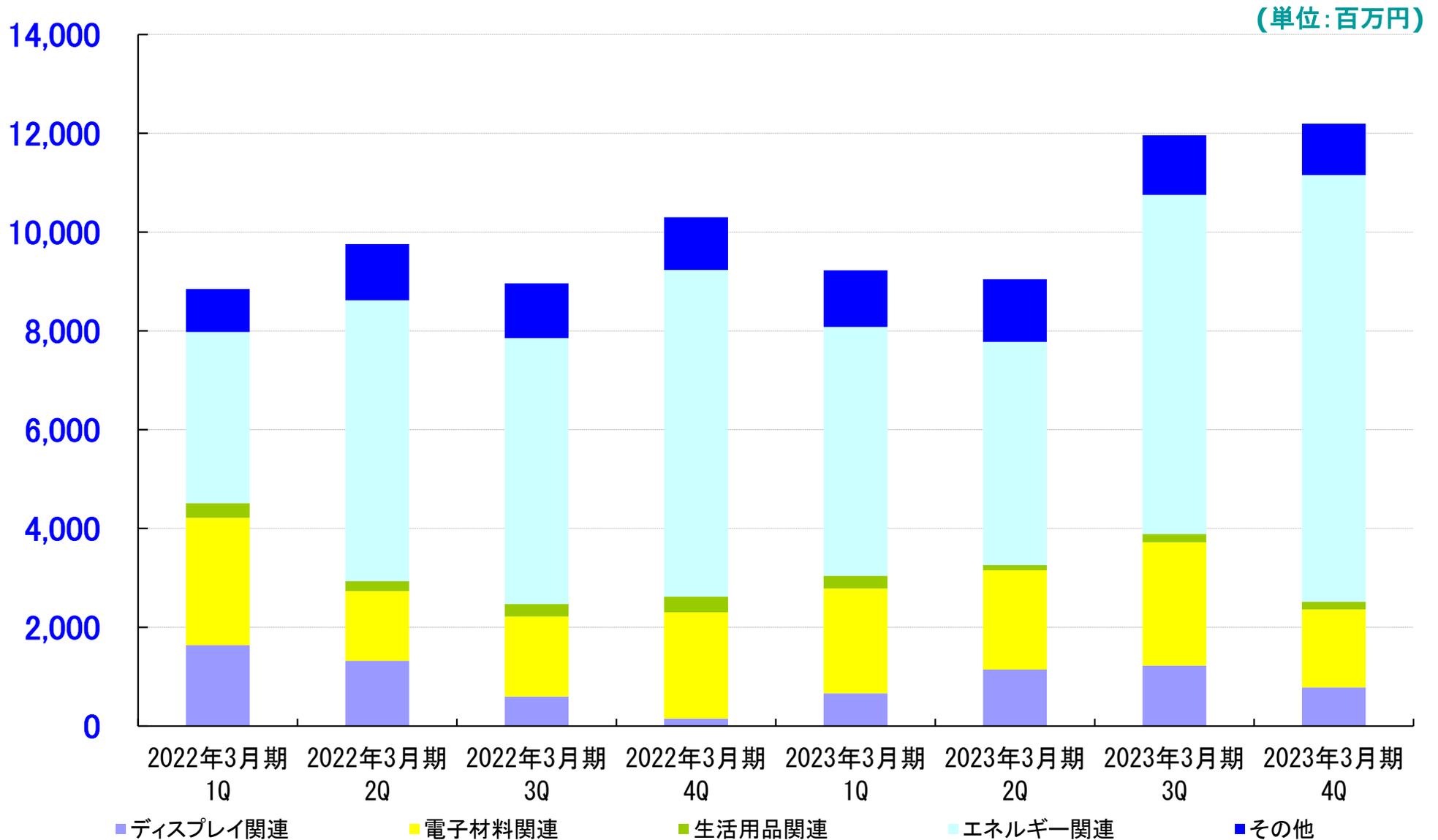
受注残高



	2021年 3月期 4Q末	2022年 3月期 4Q末	2023年 3月期 4Q末
海外	10,522	9,640	4,703
国内	5,211	5,128	5,047
合計	15,734	14,768	9,750

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期の数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

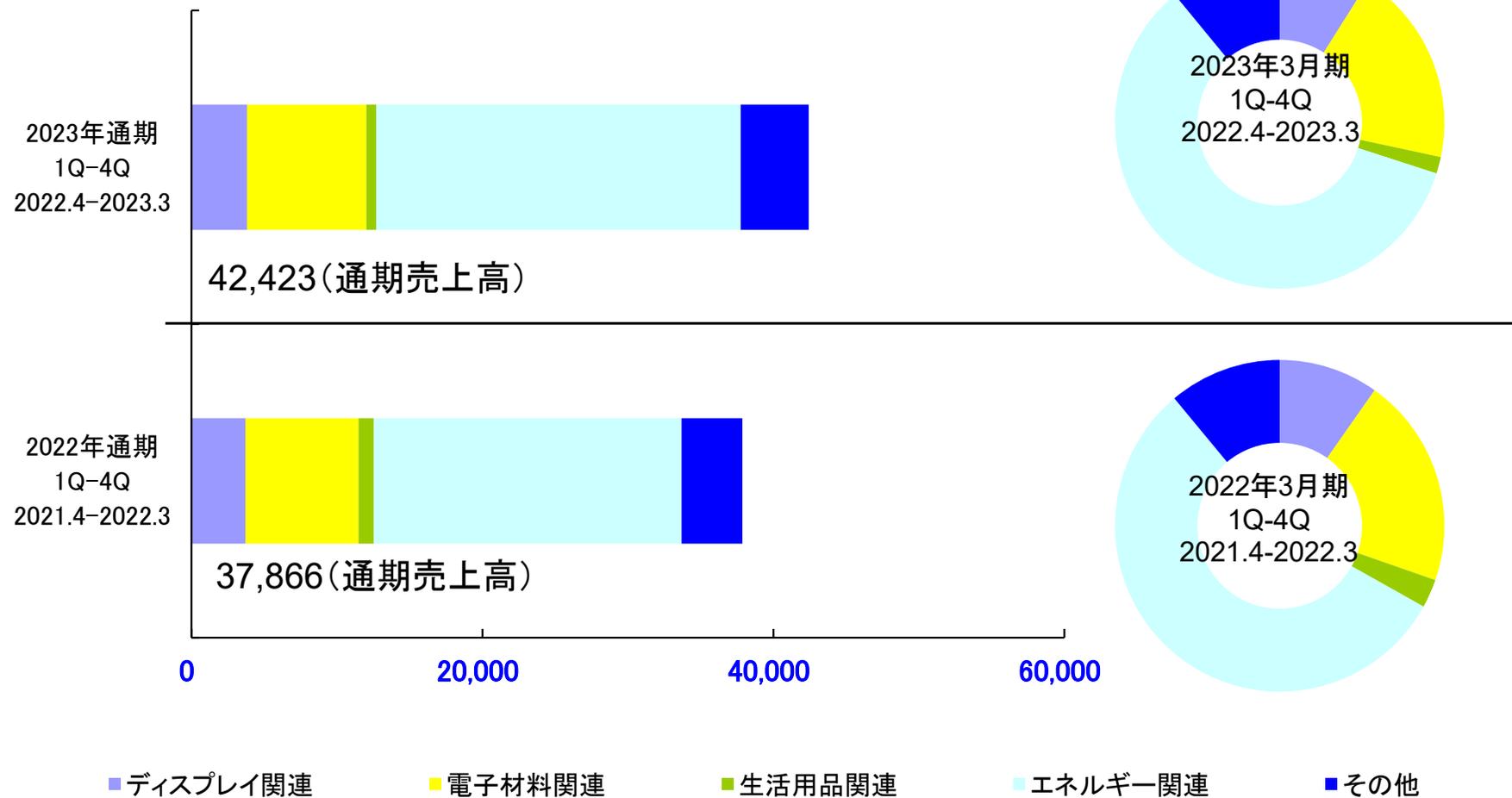
用途別セグメント① 売上高（四半期ごと）



「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期の数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

用途別セグメント② 売上高（通期比較）

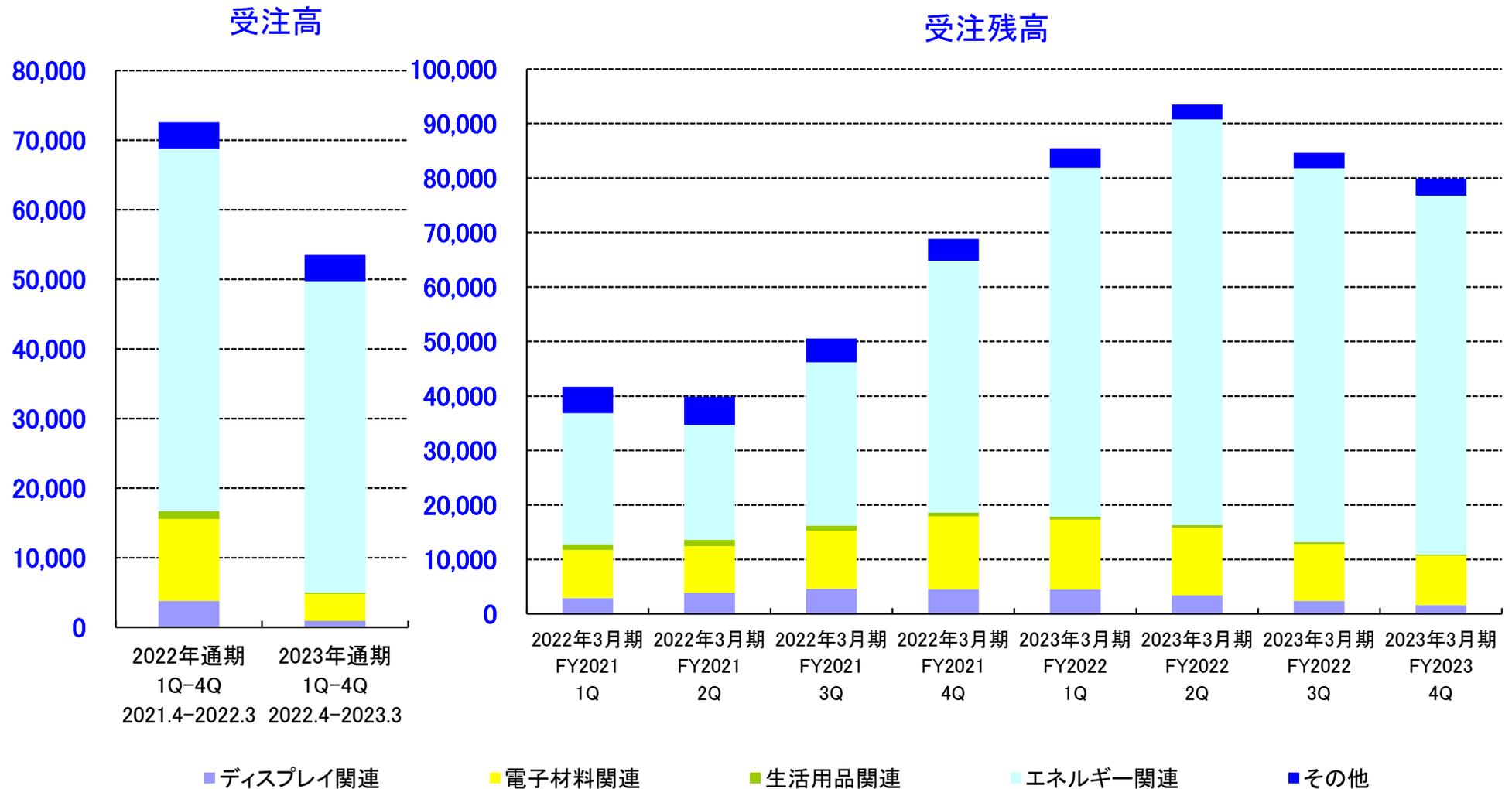
(単位:百万円)



「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期の数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

用途別セグメント③

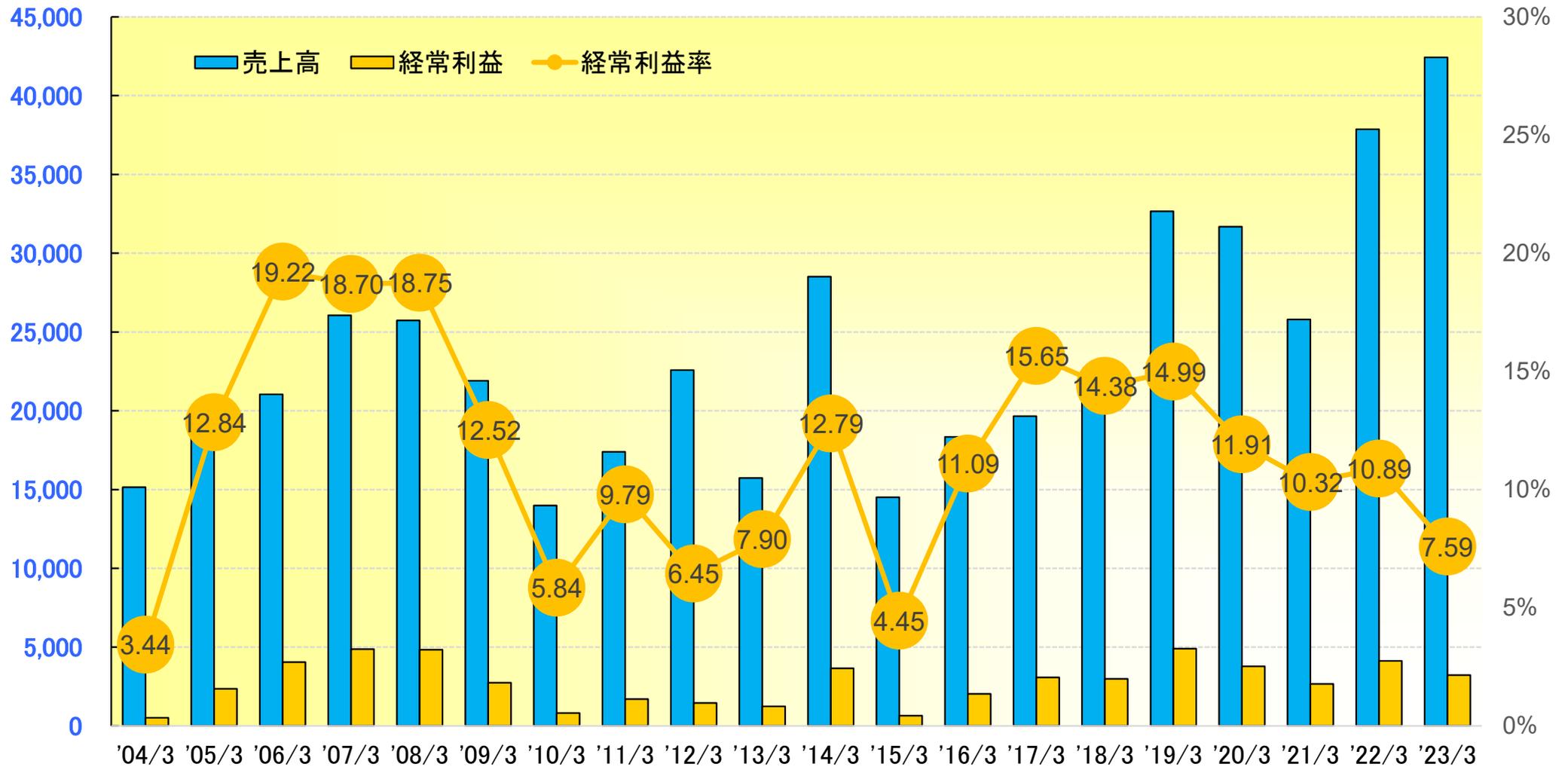
(単位:百万円)



「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期の数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

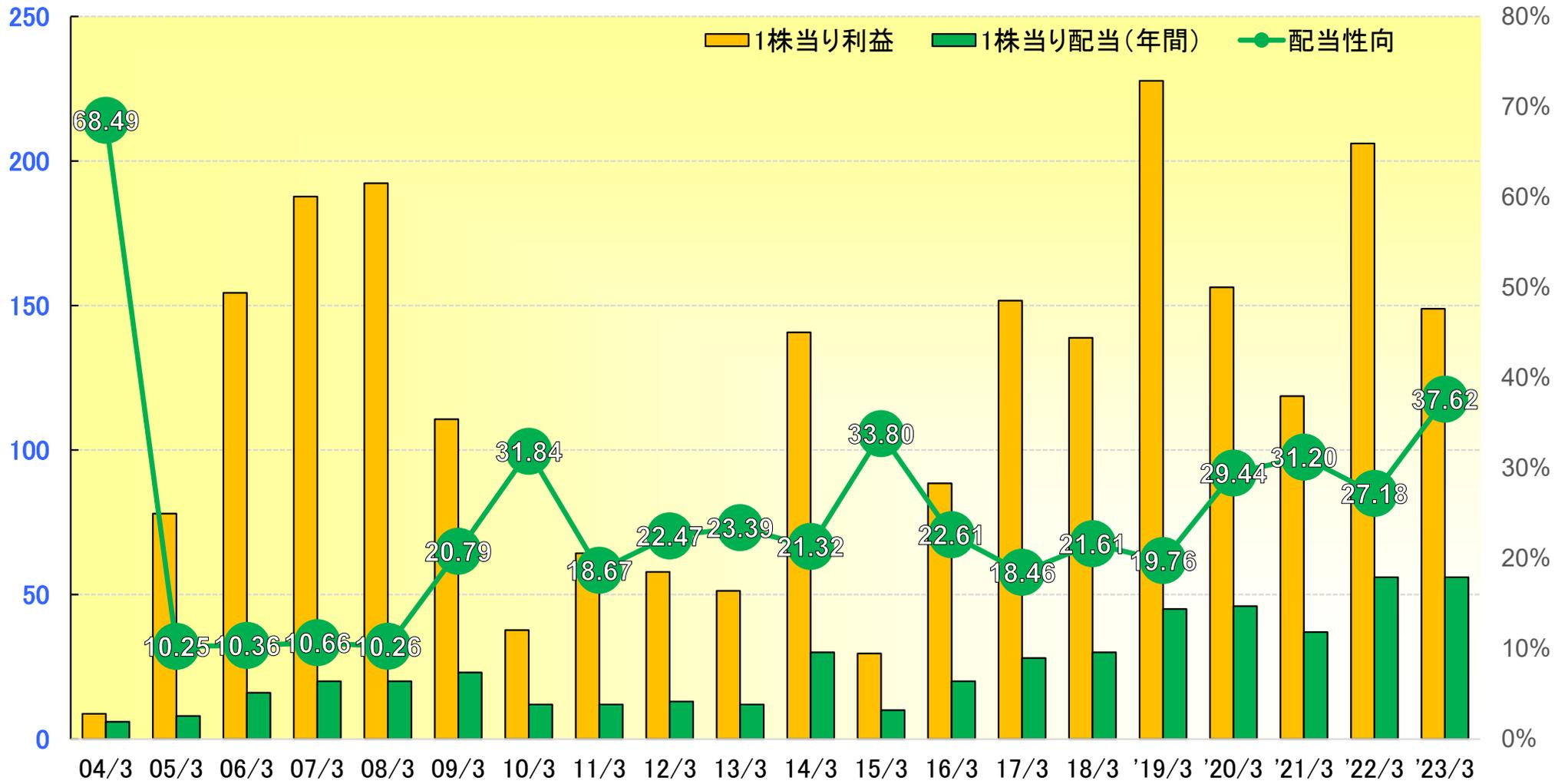
過去業績推移①

(単位:百万円)



過去業績推移②

(単位:円)



ヒラノグループトータルコンセプト “人と技術と未来を創る”

エネルギー分野を中心に環境に貢献すべく開発をすすめてまいります。

- リチウムイオン電池用
- 燃料電池・太陽電池
- 極薄セラミックシート
- メディカルテープ
- 導電性フィルム



塗工・成膜設備の連続生産性に優れる特徴があり、近年、目標とされている持続可能な社会の実現のためにも、環境負荷の軽減に貢献できることから、広い産業分野で活用されております。

当社グループのトータルコンセプトである「人と技術と未来を創る」を基本理念として、開発部門、設計部門、製造部門が連携し、ユーザーニーズである生産設備の高速化、広幅化、高精度化からなる未来を創る技術を磨いてまいりました。

製品の差別化と安定供給を目指し、コア部品である、高精度ロールとスロットダイの内作化に取組み、技術と生産ノウハウを蓄積を進めております。

また、高圧プレステスト装置の開発、連続型スパッタ装置の幅広い用途展開に向け、複数成膜源対応、複数前処理源対応、両面成膜などの高機能対応に加え、低価格帯の普及型設備等も開発しております。

HV・EV分野



電子材料分野

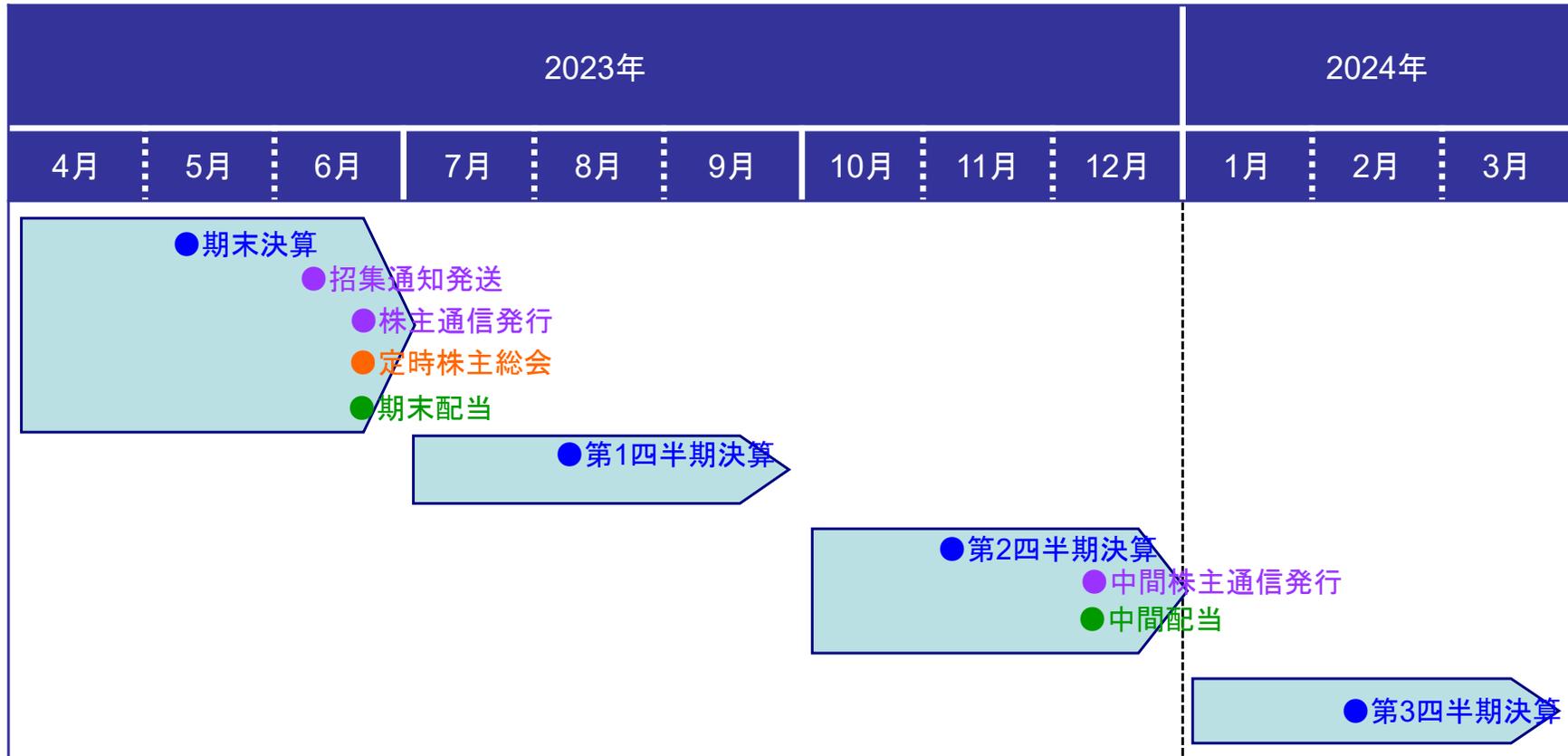


塗工機関連機器では、EV用リチウムイオン二次電池のニーズ拡大により、電極塗工装置の高速生産及び高性能化ニーズが高まっています。多層同時塗工、両面同時塗工技術等の開発に加え、より薄く取扱いが難しい金属箔の安定走行技術、熱風と赤外線による乾燥制御技術でも高評価をいただいております。

ディスプレイの薄型化やフレキシブル化に寄与する光学機能性フィルムの各種塗工プロセス設備では、広幅フィルムの安定走行技術、高い塗膜精度と、電子材料分野で培ったクリーン化技術に更なる進化を進めております。

化工機関連機器では、EVや安全運転サポート車に搭載される電子機器の増大により、益々、電子材料の高性能化と高集積化が進んでおります。薄物から厚物まで幅広い範囲の積層セラミックコンデンサー用セラミックシート成形機に求められる高い膜厚精度と、乾燥制御技術、成膜プロセスのクリーン化技術開発を継続し市場をリードしております。

プリント基板材料分野では搬送・高温加圧・貼合技術に改善を加え、電子機器の小型化に寄与する薄物、高集積積層基板の実用化に貢献致しました。透明ポリイミドフィルムの成膜技術開発、炭素繊維等のシート成形、高温延伸機、高温熱処理装置、連続スパッタ装置など次世代を担う材料に対応する設備開発を進めてまいります。



本資料について

本資料は情報提供のみを目的として作成するものであり、当社株式の購入を含め、特定の商品の募集・勧誘・営業等を目的としたものではありません。

本資料で提供している情報は、金融商品取引法、内閣府令、規則並びに東京証券取引所上場規則等で要請され、またはこれらに基づく開示書類ではありません。本資料には財務状況、経営結果、事業に関する一定の将来予測並びに当社の計画及び目的に関する記述が含まれます。

このような将来に関する記述には、既知または未知のリスク、不確実性、その他実際の結果または当社の業績が明示的または黙示的に記述された将来予測と大きく異なるものとなる要因が内在することにご留意ください。これらの将来予測は、当社の現在と将来の経営戦略及び将来において当社の事業を取り巻く政治的、経済的環境に関するさまざまな前提に基づいて行われています。

本資料で提供している情報に関しては万全を期しておりますが、その情報の正確性、確実性及び公正性を保証するものではなく、当社は掲載された情報またはデータの誤りまたは不正確に関しまして、一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。

予告なしに内容が変更または廃止される場合があります。

2023年5月12日

この資料に関するお問い合わせは

株式会社ヒラノテクシード 総務部(TEL0745-57-0681)まで